west

Generate Collection

L10: Entry 11 of 35

File: JPAB

Jan 23, 1998

PUB-NO: JP410022767A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10022767 A

TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER AND MANUFACTURE THEREFOR

PUBN-DATE: January 23, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TO

TAGAMI, JTOSHIO ANASAKO, KENICHI OKADA, YOSHIO SHIMAMURA, HAJIME

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

COUNTRY

OKI ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP08179042 APPL-DATE: July 9, 1996

INT-CL (IPC): H03 H 9/145; H01 P 1/213; H03 H 3/08

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the burning, chipping and cracking of a connection line by coating the line for connecting the <u>serial</u> arms and <u>parallel</u> arms of an interdigital transducer with an Au film.

SOLUTION: The <u>serial</u> arms S1 and S2 and the <u>parallel</u> arms P1 and P2, etc., of the interdigital transducer comprising the comb-line pattern of an A1-Cu alloy are formed on a piezoelectric substrate 1 composed of LiTaO3 and this <u>surface acoustic wave</u> filter for an antenna stage branching filter for connecting an antenna terminal 2 and a transmission side terminal 3 is constituted. In this case, the connection line 10 of a T shape composed of the Au film is overlapped and put on the connection part of the <u>serial</u> arms S1 and S2 and the <u>parallel</u> arms P1 and P2. At this point, the pattern of the connection line 10 is added by utilizing a masking pattern for forming a wire bonding pad and the Au film of a thickness 0.4μm is put on the base of a Cr film for instance. By lowering the electric resistance of the part of the connection line 10, heat generation by the passing of the high frequency <u>power</u> of 2-6W from the transmission side terminal 3 is suppressed.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-22767

(43)公開日 平成10年(1998) 1月23日

最終頁に続く

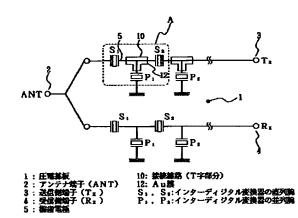
(51) Int.CL.8		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
H03H	9/145		7259 – 5 J	H03H	9/145		D
			7259 – 5 J				С
H01P	1/213			H01P	1/213		M
H03H	3/08		7259-5 J	H03H	3/08		
				審查請求	未請求	請求項の数5	OL (全 5 頁)
(21)出願番号	+	特顧平8-179042		(71)出顧人			
(22)出顧日		平成8年(1996)7			工業株式会社 性区域ノ用1で	3 7 投19具	
(なん) 江原(口		一种64(1990) 7	71 2 11	(72)発明者	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 田上 俊男		
				(12/)[3]]	•		17番12号 沖電気
						式会社内	ar High Hand
				(72)発明者			
					東京都	- 特区虎ノ門1丁	17番12号 沖電気
					工業株	式会社内	
				(72)発明者	岡田 夕	好生	
					東京都洋	巻区虎ノ門1丁	目7番12号 沖電気
					工業株	式会社内	
				(74)代理人	弁理士	清水 守 ぴ	\$1名)

(54) 【発明の名称】 表面弾性被フィルタ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 チップクラックや焼損を招くことがなくなり、耐電力性を高めることができる表面弾性波フィルタ及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 アンテナ段デュプレクサに用いる表面弾性波フィルタにおいて、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)を接続する線路10(T字部分)をAu膜12で被覆する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 アンテナ段デュプレクサに用いる表面弾 性波フィルタにおいて、

インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕を接続する線路をAu膜で被覆するようにしたことを特徴とする表面弾性波フィルタ。

【請求項2】 請求項1記載の表面弾性波フィルタにおいて、前記線路はA1-Cu合金膜からなり、その上にCr膜を介してAu膜を形成することを特徴とする表面弾性波フィルタ。

【請求項3】 請求項1記載の表面弾性波フィルタにおいて、前記線路はA1-Cu合金膜からなり、その上にNiCr膜を介してAu膜を形成することを特徴とする表面弾性波フィルタ。

【請求項4】 アンテナ段デュプレクサに用いる表面弾性波フィルタの製造方法において、(a)インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕をA1-Cu合金膜により形成する工程と、(b)前記インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕を接続する線路をAu膜で被覆す 20る工程とを施すことを特徴とする表面弾性波フィルタの製造方法。

【請求項5】 請求項4記載の表面弾性波フィルタの製造方法において、前記Au膜の形成をワイヤボンディングパッドの形成と同一の工程で行うことを特徴とする表面弾性波フィルタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話や通信端末に使用するアンテナ段分波器用表面弾性波フィルタ (以下、SAW-Fと表す)及びその製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、このような分野の技術としては、 例えば、以下に示すようなものがあった。図5は従来の アンテナ段のSAWデュプレクサの回路構成図、図6は その櫛歯パターンの上面図、図7は図6のB-B線断面 図である。

【0003】図5において、1は水晶やLiTaO3等からなる圧電基板、2はアンテナ端子(ANT)、

 S_1 、 S_2 、…は I DT (インターディジタル変換器: 圧電基板 1 上に形成された 2 つの相互に入り組んだ櫛形 金属パターンであり、マイクロ波電圧と S AWとの相互 交換を行う)からなる直列腕、 P_1 、 P_2 ,…は I DT からなる並列腕、 3 は送信側端子(T x)、 4 は受信側端子(R x)である。

【0004】図6に示すように、SAW-Fの櫛歯電極及び接続線路5はA1もしくはA1-Cu合金で形成され、これが直列及び並列に接続されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、SAWデュプレクサの送信側には、大電力がかかるため、図5の点線で囲んだ部分6の焼損により、チップが破壊するといった問題があった。本発明は、上記問題点を除去し、チップクラックや焼損を招くことがなく、耐電力性を高めることができる表面弾性波フィルタ及びその製造

2

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 10 成するために、

方法を提供することを目的とする。

(1)アンテナ段デュプレクサに用いる表面弾性波フィルタにおいて、インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕を接続する線路をAu 膜で被覆するようにしたものである。

【0007】したがって、接続線路 (T字部分) の発熱 を抑制することができ、チップクラックや焼損を招くこ とがなくなり、耐電力性を高めることができる表面弾性 波フィルタを得ることができる。

(2)上記(1)記載の表面弾性波フィルタにおいて、 前記線路はAl-Cu合金膜からなり、その上にCr膜 を介してAu膜を形成するようにしたものである。

【0008】したがって、上記(1)の効果に加えて、Cr膜を介したAu膜の形成によるワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2 とインターディジタル変換器の並列腕P1 (P2)との接続線路(T字部分)のCr膜を介したAu被覆膜を形成することができる。

- (3)上記(1)記載の表面弾性波フィルタにおいて、前記線路はA1-Cu合金膜からなり、その上にNiC r膜を介してAu膜を形成するようにしたものである。【0009】したがって、上記(1)の効果に加えて、NiCr膜を介したワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1 (P2)との接続線路(T字部分)のNiCr膜を介したAu被覆膜を形成することができる。
- (4)アンテナ段デュアレクサに用いる表面弾性波フィルタの製造方法において、インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕をA1-C40 u合金膜により形成する工程と、前記インターディジタル変換器の直列腕とインターディジタル変換器の並列腕を接続する線路をAu膜で被覆する工程とを施すようにしたものである。

【0010】したがって、簡単な工程で信頼性の高い表面弾性波フィルタを製造することができる。

(5)上記(4)記載の表面弾性波フィルタの製造方法 において、前記Au膜の形成をワイヤボンディングパッ ドの形成と同一の工程で行うようにしたものである。

【0011】したがって、ワイヤボンディングパッドの 50 形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕 S1 , S2 とインターディジタル変換器の並列腕P
1 (P2)との接続線路 (T字部分)のAu被覆膜を形成することができ、コストダウンを図ることができる。
【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の実施例を示すアンテナ段のSAWデュプレクサの回路構成図、図2は図1のA部の拡大平面図、図3は図2のAーA線断面図である。なお、ここで、従来のものと同じ部分については、同じ符号を付してそれらの説明は省略し10ている。

【0013】これらの図に示すように、圧電基板1上には、A1-Cu膜からなるインターディジタル変換器の直列腕S1, S2 とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)をつなぐ接続線路10は三叉路(T字部分)になっている。この部分には、高周波特性上、ジュール熱が発生し、チップクラック(圧電基板1の基材のLiTaO3)を招き易いので、この実施例では、この部分にCr膜11を介してAu膜12を形成するようにしている。ここで、Cr膜11は接続線路であるA1-20Cu膜にAu膜が接着し易いようにするためのものである。

【0014】なお、Cr-Au膜に代えて、NiCr-Au膜を被覆する。すなわち、NiCr膜を介してAu膜12を形成するようにしてもよい。このように、Cr-Au膜(NiCr-Au)膜を被覆することによって、熱抵抗を減らすようにしている。このように構成したので、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)の発熱を抑制することができ、チ30ップクラックや焼損を招くことがなくなり、耐電力性が向上した。

【0015】更に、より具体的には、以下のような効果を奏することができる。AuとAlの導電率は、略同等なので、単純にAl(+5%Cu)厚さ0.4μmにCr-Au(厚さ0.4μm)をカバーとして付けた場合、その部分の導電度は2倍(電気抵抗は1/2)となる。これは発熱(ジュール熱)の低減をもたらし、耐電力を増すことになる。Auカバーの幅を広くしたり、更に、Auカバーの厚みを増したりすると、より導電度は40上がり(電気抵抗は下がり)、耐電力性が向上することが、実験により確認できた。

【0016】図4は従来の表面弾性波フィルタと本発明の表面弾性波フィルタとの耐電力特性を示す図である。なお、ここで、環境温度は25°C、周波数は800~900MHz、入力パワーは2~6wである。この図から明らかなように、Auカバーなしの場合は耐電力2w、Auカバー有(厚さ0.4μm)の場合は耐電力4w、Auカバー有(厚さ0.8μm)の場合は耐電力6wを示した。

【0017】次に、この表面弾性波フィルタの製造方法について説明する。

(1)まず、圧電基板1上にA1-Cu合金のインターディジタル変換器(櫛歯パターン)を形成する。

(2)次いで、ワイヤボンディングパッドの形成用マスクパターンに、上記したインターディジタル変換器の直列腕S1, S2 とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)10の形成用マスクパターンを付加しておき、Cr膜11を介したAu膜12によるワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2 とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)10のCr膜11を介したAu膜12の形成を行う。

【0018】また、ワイヤボンディングパッドの形成が NiCr-Au膜によって行われる場合には、これに対応して、インターディジタル変換器の直列腕 S1, S2 とインターディジタル変換器の並列腕 P1 (P2)との 接続線路 (T字部分)のNiCr膜を介した Au被 複膜 の形成を同時に行うようにする。このように、ワイヤボンディングパッドと T字部分の被覆とを同時に行うことができるので、本発明における特別な工程増はない。つまり、コストアップを防ぐことができる。

【0019】なお、上記実施例では送信側のインターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1 (P2)との接続線路(T字部分)へのAu膜の被覆について述べたが、受信側のインターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1 (P2)との接続線路(T字部分)へのAu膜の被覆に適用できることは言うまでもない。

【0020】また、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

[0021]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に よれば、以下のような効果を奏することができる。

(1)請求項1記載の発明によれば、接続線路(T字部分)の発熱を抑制することができ、チップクラックや焼損を招くことがなくなり、耐電力性を高めることができる表面弾性波フィルタを得ることができる。

【0022】(2)請求項2記載の発明によれば、上記(1)の効果に加えて、Cr膜を介したAu膜の形成によるワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)のCr膜を介したAu被覆膜を形成することができる。

50 【0023】(3) 請求項3記載の発明によれば、上記

(1)の効果に加えて、NiCr膜を介したワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)のNiCr膜を介したAu被覆膜を形成することができる。

(4)請求項4記載の発明によれば、簡単な工程で信頼性の高い表面弾性波フィルタを製造することができる。【0024】(5)請求項5記載の発明によれば、ワイヤボンディングパッドの形成と同時に、インターディジタル変換器の直列腕S1, S2とインターディジタル変 10換器の並列腕P1(P2)との接続線路(T字部分)のAu被覆膜を形成することができ、コストダウンを図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示すアンテナ段のSAWデュ プレクサの回路構成図である。

【図2】図1のA部の拡大平面図である。

【図3】図2のA-A線斯面図である。

【図4】従来の表面弾性波フィルタと本発明の表面弾性 波フィルタとの耐電力特性を示す図である。

【図5】従来のアンテナ段のSAWデュプレクサの回路 構成図である。

【図6】従来のアンテナ段のSAWデュプレクサの櫛歯 パターンの上面図である。

【図7】図5のB-B線断面図である。

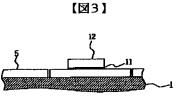
【符号の説明】

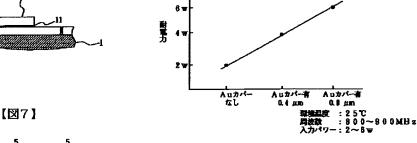
- 1 圧電基板
- 0 2 アンテナ端子(ANT)
 - 3 送信側端子(Tx)
 - 4 受信側端子(Rx)
 - 5 SAW-Fの櫛歯電極及び接続線路
 - S1, S2 インターディジタル変換器の直列腕
 - P1 (P2) インターディジタル変換器の並列腕
 - 10 接続線路(T字部分)
 - 11 Cr膜又はNiCr膜

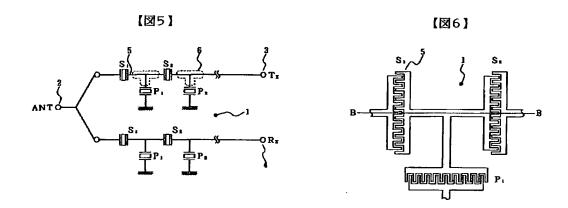
【図4】

12 Au膜

【図2】







フロントページの続き

(72)発明者 島村 一

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気

工業株式会社内